

2016-2022年中国银浆灌孔电路板行业市场监测及 发展趋势前瞻报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2016-2022年中国银浆灌孔电路板行业市场监测及发展趋势前瞻报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/dianlishebei/238594238594.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

银浆灌孔技术是采用物理的方法，贯通双面的导电路径连接。其制作技术是利用银质导电浆料通过丝印网版的漏印，渗入预制好的孔中，然后利用毛细管原理及抽真空的作用渗透到孔径内，使孔内注满银、碳质、铜质导电印料，进而形成互连导通孔。

印制线路板以导电层分类，可分为单面、双面、多层三类。双面和多层原则有着一共同点，就是两者都需要导体连接其层面。为层面之间添设导体的普通方面，就在于印制电路板上的各指定点先冲孔或钻孔，然后在孔壁的周围形成导体层。该导体层就会在各层面之间制造电气触点形成回路。形成互孔连接的方法很多，如：引线、铆钉或无电镀方式（化学沉铜法，黑化法）将导体物质镀上孔壁，再直接电镀法等等。这类方式各有利弊，也非常有效，但制造成本昂贵及带来的环保的复杂。贯孔技术的产生，形成有效的互连孔方式，可弥补了这一缺陷。相对于金属化孔而言，银浆贯孔工艺有以下几个方面的特点：（1）加工方法简便，技术容易掌握；（2）可用FR-1的酚醛纸基板代替CEM-3、FR-4的环氧玻璃布板，节约基材成本；（3）采用物理方法贯孔，节约了双面板制作时需用的大量水、电、热源；（4）节省了大量的贵重金属如铜、镍、金、锡铅等，且无三废污染；（5）适合大批量流水作业，缩短了双面板的生产周期。

我国银胶贯孔电路板生产工艺虽然发展时间较长，但国内大规模使用银胶贯孔生产电路板并不成熟，企业规模不大，占比PCB行业份额较小，2014年市场规模预计在21亿元左右。目前国内银胶贯孔电路板与铜浆贯孔电路板生产规模逐渐分化，铜浆贯孔板比例有所提高，预计2016年铜浆贯孔板达到银胶贯孔的2被左右。目前银胶贯孔电路板市场仍然较大，对其他PCB板市场产品替代率较高，银胶贯孔将渗透双面PTH12-15%的产品市场，而铜胶贯孔将可取代双面PTH25%的领域。若使用铜胶将可以相对于传统PTH产品降低15%成本，因此，未来重点研发铜胶贯孔板成为一大方向。

2014年，中国印制电路板行业市场规模为1491.07亿元，同比增长5.97%。预计2016-2022年，中国印制电路板行业的市场规模将从1595.58亿元增长到2191.36亿元，年增长率在6-7%之间。随着对PCB行业环保要求的提高，实现清洁生产是PCB行业实施可持续发展的有效途径之一，改革工艺流程，开展清洁生产，在源头和过程中减少污染物的产生，特别是在PCB板孔金属化工艺向环保型新工艺发展具有广阔的市场和前景

中国报告网发布的《2016-2022年中国银浆灌孔电路板行业市场监测及发展趋势前瞻报告》首先介绍了银浆灌孔电路板行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。

【报告大纲】

第一部分 银浆灌孔电路板行业发展现状

第一章 银浆灌孔电路板行业特征分析

第一节 产品概述

第二节 产业链分析

第三节 中国银浆灌孔电路板行业在国民经济中的地位

第四节 银浆灌孔电路板行业生命周期分析

一、行业生命周期理论基础

二、银浆灌孔电路板行业生命周期

第二章 银浆灌孔电路板行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境分析

第二节 国际贸易环境分析

第三节 宏观政策环境分析

第四节 中国银浆灌孔电路板行业政策环境

第五节 行业运行环境对中国银浆灌孔电路板行业的影响分析

第三章 银浆灌孔电路板行业市场分析

第一节 2009-2014年中国银浆灌孔电路板市场规模及增速

第二节 影响银浆灌孔电路板市场规模的因素

第三节 2016-2022年中国银浆灌孔电路板市场规模及增速预测

第四节 银浆灌孔电路板市场发展潜力分析

第五节 市场需求现状及发展趋势

第二部分 银浆灌孔电路板市场运行分析

第四章 区域市场分析

第一节 区域市场分布总体情况

第二节 重点省市市场分析

第三节 重点省市进口分析

第五章 银浆灌孔电路板细分产品市场分析

第一节 细分产品特色

第二节 细分产品市场规模及增速

第三节 2016-2022年细分产品市场规模及增速预测

第四节 重点细分产品市场前景预测

第六章 银浆灌孔电路板行业生产分析

第一节 2009-2014年银浆灌孔电路板行业生产规模及增速

第二节 2016-2022年银浆灌孔电路板行业产量产能变化趋势

第三节 行业领导者的生产现状及产品策略

第四节 银浆灌孔电路板行业生产中存在的问题

第七章 银浆灌孔电路板行业区域生产分析

第一节 区域生产分布总体情况

第二节 重点省市生产分析

第三节 重点省市出口分析

第三部分 银浆灌孔电路板行业竞争格局分析

第八章 银浆灌孔电路板行业竞争分析

第一节 竞争分析理论基础

第二节 银浆灌孔电路板行业竞争格局

一、现有竞争者分析

二、潜在进入者分析

三、供应商的讨价还价能力分析

四、买方的讨价还价能力分析

五、替代品的威胁

第三节 银浆灌孔电路板行业市场集中度分析

第四节 竞争的关键因素

第九章 银浆灌孔电路板产品价格分析

第一节 2009-2014年银浆灌孔电路板价格走势

第二节 影响银浆灌孔电路板产品价格的关键因素分析

一、成本

二、供需情况

三、关联产品

四、其他

第三节 2016-2022年银浆灌孔电路板产品价格变化趋势

第十章 银浆灌孔电路板行业渠道分析

一、渠道形式及对比

二、各类渠道对银浆灌孔电路板行业的影响

三、主要银浆灌孔电路板企业渠道策略研究

四、各区域主要代理商情况

第十一章 银浆灌孔电路板行业进出口分析

第一节 出口分析

一、我国银浆灌孔电路板行业出口总量及增长情况

二、银浆灌孔电路板海外市场分布情况

三、银浆灌孔电路板行业经营海外市场的主要品牌

四、银浆灌孔电路板行业出口态势展望

第二节 进口分析

第四部分 银浆灌孔电路板市场全景调研

第十二章 银浆灌孔电路板上游行业分析

第一节 上游行业发展现状

第二节 上游行业发展趋势

第三节 上游行业对银浆灌孔电路板行业的影响

第十三章 银浆灌孔电路板下游行业分析

第一节 下游行业发展现状

第二节 下游行业发展趋势

第三节 下游行业对银浆灌孔电路板行业的影响

第十四章 银浆灌孔电路板行业用户分析

第一节 用户认知程度分析

第二节 用户需求特点分析

第三节 用户购买途径分析

第十五章 替代品分析

第一节 替代品发展现状

第二节 替代品发展趋势

第三节 替代品对银浆灌孔电路板行业的影响

第十六章 互补品分析

第一节 互补品发展现状

第二节 互补品发展趋势

第三节 互补品对银浆灌孔电路板行业的影响

第十七章 银浆灌孔电路板行业工艺技术发展分析

第一节 工艺技术发展现状

第二节 工艺技术发展趋势

第十八章 银浆灌孔电路板行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 相关行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 社会需求变化

第十九章 重点银浆灌孔电路板企业分析

第一节 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第二节 天津普林电路股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第三节 惠州中京电子科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第五节 沪士电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第六节 广东汕头超声电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第七节 深圳松维电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

第八节 深圳丹邦科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

四、企业发展战略

第九节 珠海方正科技多层电路板有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业竞争优势

第十节 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业经营情况

三、企业发展战略

第五部分 银浆灌孔电路板行业投资战略研究

第二十章 银浆灌孔电路板行业进入壁垒及机会分析

第一节 行业进入壁垒分析

第二节 行业进入机会分析

一、行业热点事件

二、行业热点事件对整个行业的影响分析

第三节 银浆灌孔电路板行业进入机会

第二十一章 银浆灌孔电路板行业投资风险分析

第一节 环境风险

第二节 产业链上下游风险

第三节 行业政策风险

第四节 市场风险

第五节 其他风险

第二十二章 银浆灌孔电路板行业市场前景与预测分析

第一节 行业重点企业投资行为分析

第二节 银浆灌孔电路板行业盈利水平分析

第三节 行业投资机会分析

一、细分市场机会

二、新进入者投资机会

三、产业链投资机会

第四节 银浆灌孔电路板行业总体机会评价

第二十三章 银浆灌孔电路板行业投资策略分析

第一节 产品定位与定价

第二节 成本控制建议

第三节 技术创新

第四节 渠道建设与营销策略

第五节 投资策略

第六节 如何应对当前经济形势

图表目录

图表 电路板产业链结构图

图表 PCB各类产品所处生命周期情况

图表 2014年1-4季度GDP初步核算数据

图表 GDP环比和同比增长速度

图表 2010-2014年国内生产总值及其增长速度

图表 2014年年末人口数及其构成

图表 2010-2014年城镇新增就业人数

图表 2014年1-12月我国规模以上工业增加值

特别说明：中国报告网所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场行情。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/dianlishebei/238594238594.html>